

主催：公益社団法人応用物理学会 微小光学研究会

協賛：日本光学会，電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ，オプトロニクス社



第 176 回微小光学研究会

「光が学ぶ半導体高密度パッケージング技術」

第 176 回研究会では，最先端半導体技術（半導体素子の性能向上，製造工程の効率化，新たな応用展開）と"光"の活用に焦点を当てました．半導体の新たな潮流である中工程による 3 次元積層やチップレット集積，ヘテロジニアス集積，高密度配線，層間絶縁材料などを中心にご講演いただきます．さらに，実用化のカギの一つである標準化の動向についても，電子回路と光回路の両領域における専門家をお招きしました．その中で，"光"がどのように活用されるのか，あるいは最先端半導体製造技術のキー技術になるのかを明らかにできれば幸いです．

日時： 2025 年 9 月 3 日（水）13:00～17:30

会場： 工学院大学新宿キャンパス 3F アーバンテックホール
〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2
<https://www.kogakuin.ac.jp/campus/access.html>

※オンライン同時開催予定

交通： JR「新宿駅」西口より徒歩 5 分
京王線、小田急線、地下鉄各線「新宿駅」より徒歩 5 分
都営大江戸線「都庁前駅」より徒歩 3 分
西武新宿線「西武新宿駅」より徒歩 10 分



プログラム案

13:00～13:10	開会の挨拶	
13:10～13:50	（基調講演）チップレット集積プラットフォーム・コンソーシアム	栗田 洋一郎（東京科学大）
13:50～14:20	TSV vs. TSV-less 先端半導体パッケージ	福島 誉史（東北大）
14:20～14:50	次世代のパッケージング技術を想定した絶縁材料の開発	藤島 祥平（味の素）
14:50～15:10	《休憩》	
15:10～15:50	（基調講演）IOWN に向けた光電融合デバイスの研究開発	松尾 慎治（NTT）
15:50～16:20	光電集積実装とモジュール技術の開発	松原 孝宏，山本 崇，大石 恵，赤星 知幸（京セラ）
16:20～16:50	次世代データセンタを支える Co-Packaged Optics 技術	那須 秀行（古河電気工業）
16:50～17:20	光パッケージングにおける国際標準化動向-CPO を含めて-	磯野 秀樹（IGS コンサルティング）
17:20～17:30	閉会の挨拶	

参加費（消費税込，予稿集代を含む）：一般 5,000 円，応用物理学会員 4,000 円

学生・シニア 2,000 円，学生・シニアの応用物理学会員 1,000 円

参加申込：要事前申込，<https://www.comemoc.com/meeting/mo176.htm> よりお申込下さい

（開催日の数日前に予稿集と請求書を郵送致しますので，参加費（予稿集代を含む）をお支払いください）

問合せ先：meeting ■ comemoc.com （■を@に換えてください）

微小光学研究会 代表：伊賀 健一

運営委員長：中島 啓幾

実行委員長：横森 清

運営副委員長：波多腰 玄一

実行副委員長：宮本 智之

担当委員：荒川（横国大）、高（産総研）、波多腰（微小光学）、山口（工学院大）、横森（微小光学）

※プログラムは微小光学研究会のウェブサイト <https://www.comemoc.com/> でもご覧いただけます

※オンライン同時開催予定です．現地会場における聴講は先着順のため，会場の定員に達する場合はオンライン聴講となりますのでご了承下さい